

# 資通訊供應鏈產品晶片 資安驗證制度

V1.0

中華民國 114 年 8 月

## 目錄

1. 驗證制度概述 .....	4
2. 名詞解釋 .....	5
3. 驗證制度之管理 .....	6
4. 驗證制度之驗證流程 .....	9
5. 後市場監督管理 .....	12
6. 申請流程圖 .....	13

## 修改紀錄

制定/修訂日期	修改頁次	修改內容摘要	修改後版本別
2025.08	N/A	N/A	1.0

## 1. 驗證制度概述

### 1.1 制度目的

「資通訊供應鏈產品晶片資安驗證制度」(以下簡稱本制度)，係由數位發展部數位產業署(以下簡稱本署)訂定，旨在於建構一套具一致性與公信力的驗證機制，作為我國推動資通訊供應鏈產品晶片資安管理之核心依據，以強化整體供應鏈安全，並提升國內產業之國際競爭能力。

### 1.2 適用範圍

本制度適用於資通訊供應鏈中晶片產品、認可驗證機構、認可實驗室及申請者。

## 2. 名詞解釋

- 2.1 認證：係指由認證機構對驗證機構、測試實驗室所執行之正式資格評定程序，用以證明其具備執行驗證所需的能力。
- 2.2 驗證：係指由認可驗證機構依據本制度，對晶片產品進行符合性評估、審查及驗證決定，並出具證明之程序。
- 2.3 晶片產品：指由積體電路（Integrated Circuit, IC）所構成，並整合於資訊通信科技（ICT）產品中，具備處理、儲存、控制或通信等功能之關鍵電子模組。晶片產品範圍涵蓋晶片層、系統層與軟體層，涵蓋硬體至軟體各層級，並可作為資訊產品整體資安評估與驗證之基礎單元。

### 3. 驗證制度之管理

#### 3.1 驗證制度中角色及權責

- 3.1.1 認證機構：本制度指的認證機構為財團法人全國認證基金會 (Taiwan Accreditation Foundation, 簡稱 TAF), 負責認證驗證機構與實驗室能力。
- 3.1.2 認可驗證機構：經本署同意負責執行驗證作業之機構, 可提供證明文件。
- 3.1.3 認可實驗室：受理設計業者、製造商或終端設備製造商之申請, 提供申請者進行資安測試服務之單位。
- 3.1.4 申請者(證明文件擁有者)：係指晶片設計業者或晶片製造商, 提供技術文件與樣品, 應委託認可實驗室向認可驗證機構提出申請, 通過後授於合格證明文件。

#### 3.2 認可驗證機構資格

- 3.2.1 具備驗證及專業技術能力之合法實體機構, 資格要求如下：
  - (1). 通過 TAF ISO/IEC 17065 ; CNS 17065 產品驗證機構
  - (2). 至少 1 案晶片資安評估或測試經驗
  - (3). 通過 ISO/IEC 27001 ; CNS 27001 資訊安全管理系統

3.2.2 經本署同意, 並遵守此制度之管理要求。

#### 3.3 認可實驗室資格

- 3.3.1 具備測試及專業技術能力之合法實體機構, 並通過 TAF ISO/IEC 17025 ; CNS 17025 之測試實驗室。
- 3.3.2 經認可驗證機構評核, 並配合每年接受監督評鑑, 並遵守此制度之管理要求。
- 3.3.3 報告簽署人之要求：大學以上, 曾受過晶片資安領域相關課程達 20 小時。

#### 3.4 認可驗證機構管理

- 3.4.1 認可驗證機構經本署同意後, 其執行期間為 3 年。期滿後將由本署依據 TAF 每年監督評鑑結果進行評估後決定續辦。
- 3.4.2 認可驗證機構可執行本制度外之驗證方案, 應確保能明辨執行驗

證方案之不同，且不得有利益衝突或範圍模糊之情形。

- 3.4.3 認可驗證機構接受 TAF 監督評鑑結果若為暫時終止或撤銷，應主動通知本署。
- 3.4.4 認可驗證機構應具備符合本制度及認證機構評鑑監督之文件紀錄、資源及能力，當本署需要調閱時應即時提供，並指派符合此驗證制度資格之人員，與本署聯繫。
- 3.4.5 認可驗證機構執行驗證應遵守本制度辦理，本署保留最終裁決權。
- 3.4.6 驗證活動中產生之抱怨、申訴與糾紛處理及決議之過程，予以文件化紀錄，當本署要求時提供。
- 3.4.7 審驗報告及過程紀錄係為機密文件且為申請者所有。僅限提供給認可驗證機構及本署，或經申請者書面同意之其它單位或人員。
- 3.4.8 認可驗證機構取得本署同意後，若無法履行本制度者，本署得逕行必要之處置，並停止與認可驗證機構之合作，本署之處置包括終止、暫時終止、撤銷。

備考：認證處置為終止、暫時終止、撤銷，依循「產品驗證機構認證方案服務手冊 (TAF-PC-M01)」。

### 3.5 驗證制度之制定或修訂

- 3.5.1 本署對此驗證制度保有最終解釋權。
- 3.5.2 制定或修訂草案核准至實施之期間，視為緩衝期，認可驗證機構應於此期間針對變動內容進行因應，並就受影響範圍作出評估與調整。
- 3.5.3 緩衝期之長度應視其變動內容與性質範圍而定，至少 6 個月不等。認可驗證機構應於修正或改版公告後 20 個工作日內，主動通知其認可實驗室最新驗證之驗證制度資訊。

### 3.6 認可驗證機構之人力資源要求

- 3.6.1 認可驗證機構應具備人力、資源以滿足驗證活動，其成員皆須為機構正式人員。
- 3.6.2 對測試報告執行評估之專業人員應大學以上，曾受過晶片資安領域相關課程達 20 小時以上，且具晶片資安領域相關工作 1 年以上經驗。

- 3.6.3 對評估報告執行審查之專業人員應大學以上，曾受過晶片資安領域相關課程達 40 小時以上，且具晶片資安領域相關工作 3 年以上經驗。
- 3.6.4 認可驗證機構應提供執行驗證活動之人員名單，並保存與更新其參與驗證活動過程中所有紀錄。
- 3.6.5 認可驗證機構應每年依驗證方案之規範文件及規範性參考文件，向機構人員進行至少 6 小時培訓，並制定培訓結果的評估流程。
- 3.6.6 認可驗證機構應有人員培訓及績效查核流程，包含新進評估人員成為正式評估人員之晉用，應有參與實際案例之考核過程。
- 3.6.7 新進評估人員成為正式評估人員前，應由認可驗證機構的正式評估人員協助及指導，完整參與驗證活動中的評估執行，並留下培訓紀錄。

## 4. 驗證制度之驗證流程

### 4.1 申請、受理(初次、變更、展延)

4.1.1 欲申請驗證(含初次、變更、展延)之申請者，應備妥申請文件，透過認可實驗室遞交申請。

#### 4.1.2 申請者應檢附文件

- (1) 營利事業登記證或等同文件
- (2) 產品使用說明/手冊/指引
- (3) 產品規格書
- (4) 符合性聲明書
- (5) 認可實驗室所核發之晶片產品試驗報告

4.1.3 禁止任何申請者在未經合法授權的情況下，代表他人公司提出產品驗證申請。

4.1.4 認可驗證機構受理申請者所提交之相關文件並進行初步審核，經受理後計收驗證費用。資料不完整者應於 2 個月內完成補件，未於期限內提交，視同結束申請。

4.1.5 申請變更應檢附差異說明、必要之技術資料或其他經認可驗證機構指定之應檢附文件。資料不完整者應於 2 個月內完成補件，未於期限內提交，視同結束變更申請。

4.1.6 申請展延應檢附未變更之聲明、必要之技術資料，或其他經認可驗證機構指定之應檢附文件。資料不完整者應於 2 個月內完成補件，未於期限內提交，視同結束展延申請。

### 4.2 評估、審查及驗證決定

4.2.1 認可驗證機構依據本制度，指派條件符合 3.6 之人員執行評估、審查作業。

4.2.2 申請資通訊供應鏈產品資安驗證之產品，經審查核可後，由認可驗證機構核發證明文件，經由認可實驗室遞交予申請者。

4.2.3 評估及審查後經驗證決定且符合，應通知申請者並核發證明文件。若不符合，由認可驗證機構以書面形式告知申請者，申請者應於收到通知後 3 個月內完成改善，逾期即視為案件終止應重新

提出申請。

4.2.4 證明文件有效期為 3 年，應依認可驗證機構每年排定執行後市場監督管理持續確保其有效性。

#### 4.3 變更及展延

4.3.1 認可驗證機構受理證明文件擁有者辦理變更及展延，認可驗證機構應制定程序執行並符合本制度要求。

4.3.2 當驗證前提條件變更或發現新事證影響判定正確性時，認可驗證機構應調整先前之驗證決定，或對原驗證決定進行修正或撤銷。

4.3.3 已取得驗證證明文件之晶片產品有變更情事時，無論性質為何，應由申請者主動通知認可實驗室及認可驗證機構，並向認可驗證機構提出變更申請。

4.3.4 產品申請變更如未涉及資安功能時，且由認可驗證機構核實無誤後，得據以辦理證明文件之變動。

4.3.5 產品申請變更如涉及資安功能時，應由認可驗證機構評估其對原驗證決定之影響。若影響重大(如：用來實現資安功能之技術方法改變等情況)，須經認可實驗室補充測試，查證不影響原申請資安功能，得據以辦理證明文件之變動。若影響輕微(如：未影響原申請資安功能等情況)，得由認可驗證機構依評估結果決定是否接受並辦理證明文件變更。

4.3.6 申請者應於文件有效期間屆滿前 6 個月，透過認可實驗室向認可驗證機構提出展延申請，期限屆滿前未申請展延證明文件不得繼續使用，於證明文件有效日期屆滿前 10 個月應由認可驗證機構主動通知申請者辦理展延，若未於前述期限內通知，相關情況由認可驗證機構依個案酌情處理。

4.3.7 若未於規定期限內申請者，則應重新辦理產品驗證。

4.3.8 申請展延之產品不得有任何外觀、軟體、硬體之變更，且由認可驗證機構核實並決定其對驗證結果之影響，始得續用原驗證結果或依本制度文件第 4.3.1 要求辦理變更，必要時認可驗證機構可至現場訪查或要求申請者送樣，申請者不得拒絕。

4.3.9 展延申請經認可驗證機構核可者，得展延原證明文件有效期間 1 次。

#### 4.4 終止、暫時終止

- 4.4.1 申請者使用違法或不當之方式通過驗證，經認可驗證機構查實後，將暫時終止、終止驗證。
- 4.4.2 申請者於取得證明文件後，如因不當使用致使本署權益受損或有損機構信譽之虞者，發現者應通報認可驗證機構，由認可驗證機構視情節輕重，決定採取終止、暫時終止驗證。

備考：終止驗證及暫時終止之處置措施依循全國認證基金會「產品驗證機構處置方案」(TAF-PC-01) 所述。

## 5. 後市場監督管理

- 5.1 認可驗證機構應每年實施產品後市場監督管理，申請者不得無故規避、妨礙或拒絕。
- 5.2 申請者應提供目前儲放於倉庫之產品序號清單，供認可驗證機構進行隨機抽樣。認可驗證機構得視需要執行抽樣管理，並依照實際抽樣調整抽樣方式、對象或頻次，以執行再評估與審查作業。
- 5.3 於後市場監督管理中進行再評估之產品，其外觀、軟體、硬體規格應與證明文件所載內容一致，否則視為不符合。
- 5.4 為維護驗證制度之有效性，倘當年度監督活動中發現不符合事項，認可驗證機構得視情節增列次年度監督頻次，或撤銷相關驗證範圍之項目。
- 5.5 後市場監督結果為不符合，得暫時終止或終止驗證、撤銷申請者驗證資格及證明文件。
- 5.6 展延產品之後市場監督管理驗證週期原則為 3 年內至少執行一次。

## 6. 申請流程圖

6.1 附錄一 圖 1 認可驗證機構申請流程圖

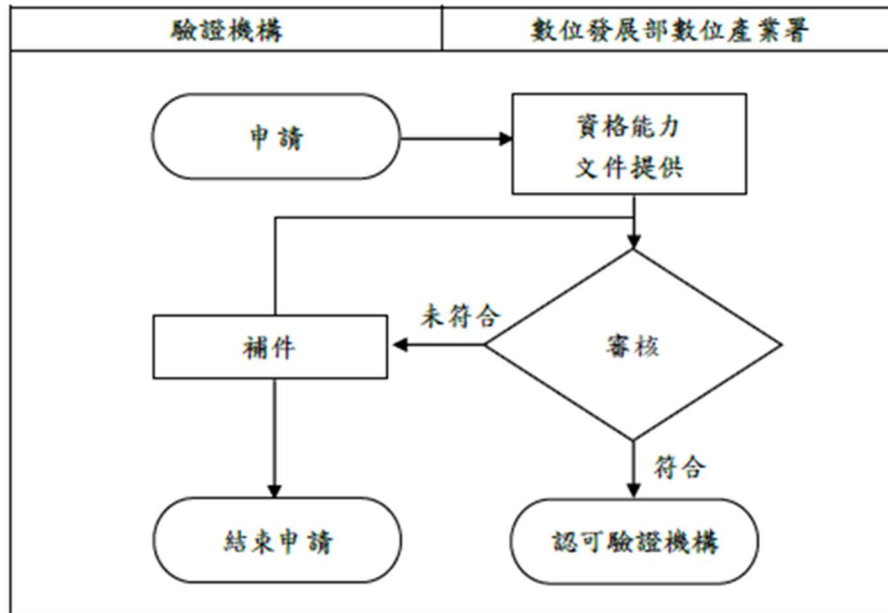


圖 1 認可驗證機構申請流程圖

6.2 附錄二 圖 2 晶片產品合格證明申請流程圖

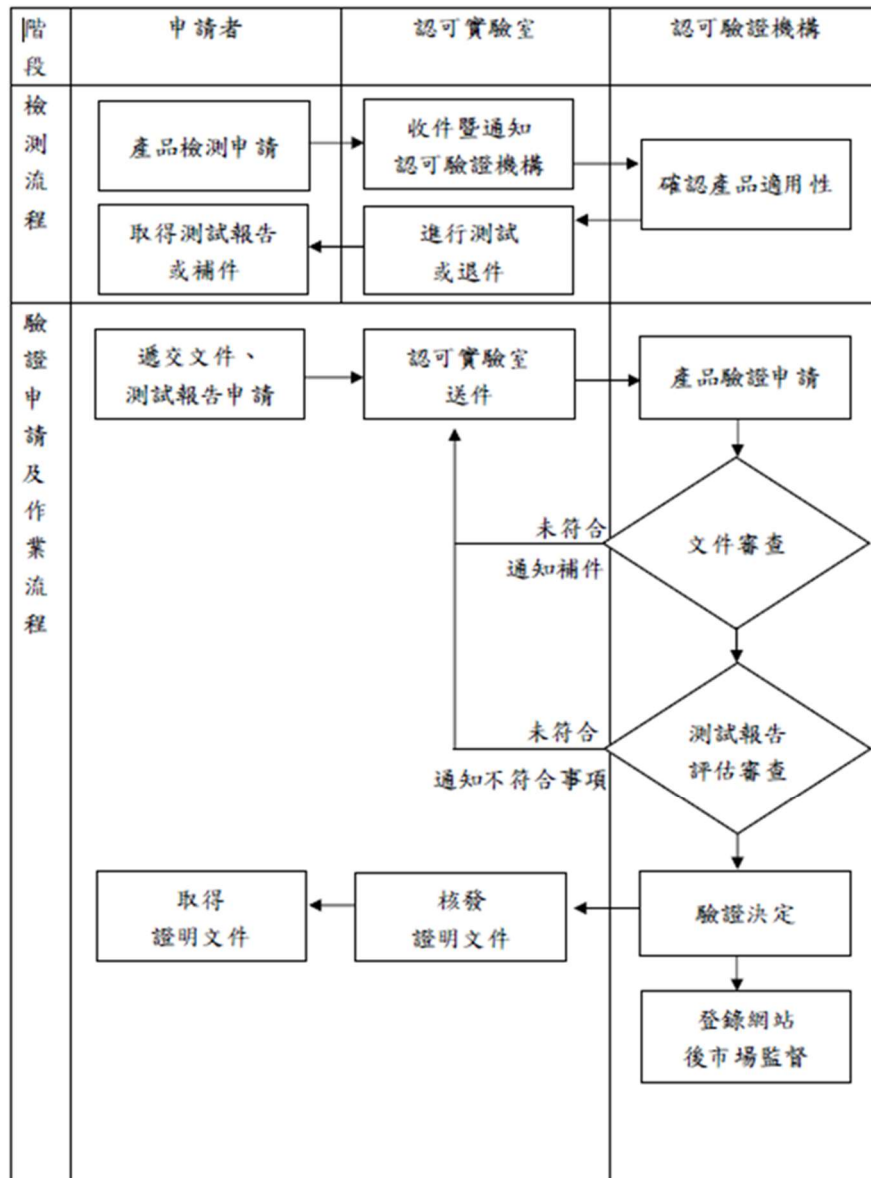


圖 2 晶片產品合格證明申請流程圖